

2008-2009年中国抛光液市 场分析与发展前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2008-2009年中国抛光液市场分析与发展前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/200810/5810.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

第一章 半导体用抛光液概述

一、抛光液的性能

二、抛光液的种类

三、二氧化硅抛光液简介

(一) SiO₂抛光液的组成

(二) 对SiO₂抛光液的性能要求

(三) 半导体硅片制造技术发展对抛光液及抛光技术提出更高的要求

四、粗抛液与精抛液的区别

五、化学机械抛光技术

(一) CMP概述

(二) CMP抛光原理

(三) CMP的技术优势

六、抛光液在其他晶体材料中的应用

(一) 砷化镓材料用抛光液的应用情况

(二) 蓝宝石单晶用抛光液的应用情况

(三) 玻璃基片用抛光液的应用情况

(四) 硬盘NiP基片用抛光液的应用情况

第二章 2007-2008年世界抛光液行业发展状况分析

一、2007-2008年世界抛光液行业概况

(一) 世界抛光液市场现状分析

(二) 世界抛光液技术分析

(三) 世界抛光液价格走势分析

二、2007-2008年世界抛光液主要国家运行情况分析

(一) 美国

(二) 日本

(三) 韩国

三、2008-2010年世界抛光液行业发展趋势分析

第三章 2007-2008年国外主要抛光液生产厂商运营情况分析

一、美国的Rodel公司

(一) 公司基本概况

(二) 公司运行与市场销售分析

(三) 公司竞争优势分析

二、美国的杜邦 (DUPON) 公司

(一) 公司基本概况

(二) 公司运行与市场销售分析

(三) 公司竞争优势分析

三、美国的Cabot公司

(一) 公司基本概况

(二) 公司运行与市场销售分析

(三) 公司竞争优势分析

四、美国的Eka 公司

(一) 公司基本概况

(二) 公司运行与市场销售分析

(三) 公司竞争优势分析

五、Ferro

(一) 公司基本概况

(二) 公司运行与市场销售分析

(三) 公司竞争优势分析

六、日本的FUJIMI 公司

(一) 公司基本概况

(二) 公司运行与市场销售分析

(三) 公司竞争优势分析

七、日本Hinomoto Kenmazai Co. Ltd

(一) 公司基本概况

(二) 公司运行与市场销售分析

(三) 公司竞争优势分析

八、韩国ACE高科技株式会社

(一) 公司基本概况

(二) 公司运行与市场销售分析

(三) 公司竞争优势分析

第四章 2007-2008年中国抛光液行业运行环境分析

一、2007-2008年中国宏观经济环境分析

(一) 中国GDP增长分析

(二) 工业发展形势分析

(三) 对外贸易变化分析

二、2007-2008年中国抛光液行业发展政策环境分析

(一) 行业政策分析

(二) 相关行业政策影响分析

(三) 行业“十一五”发展规划

三、2007-2008年中国抛光液行业发展社会环境分析

第五章 2007-2008年中国抛光液行业运行形势分析

第一章 2007-2008年我国硅片抛光液行业现状

(一) 中国抛光液行业运行特点分析

(二) 中国抛光液行业市场价格走势分析

(三) 中国抛光液技术现状分析

二、2007-2008年中国抛光液行业发展面临的问题分析

三、2007-2008年对我国抛光液行业发展的几点建议

(一) 国产化抛光液的重要性和必要性

(二) 国内市场和经济效益

(三) 技术难度和市场的开拓

(四) 多品种的开发

(五) 必须建立自己的试验研究室

(六) 质量是产品的生命线

第六章 2007-2008年中国抛光液在半导体硅材料中的应用及市场需求分析

一、2007-2008年中国半导体硅材料市场的发展与现状

(一) 世界半导体硅片市场需求趋势与生产现状

(二) 国内半导体级硅材料产业现状、发展

(三) 国内分立器件产业现状、发展

二、2007-2008年中国半导体硅材料生产工艺流程

(一) 半导体用硅材料产业链

(二) 硅片加工工序

三、2007-2008年中国半导体抛光片用抛光液的市场调查

(一) 国内单晶硅抛光片的生产厂家

(二) 国内硅抛光片用抛光液的需求状况分析

四、2007-2008年中国分立器件用抛光液的市场调查

- (一) 国内分立器件的生产厂家
- (二) 国内分立器件用抛光液的需求状况

第七章 2007-2008年中国抛光液行业市场竞争格局分析

一、2007-2008年抛光液产业集群与重点区域分析

- (一) 主要区域及发展状况
- (二) 各区域经济效益对比
- (三) 各区域重点企业点评

二、2007-2008年中国抛光液企业竞争态势与行为

- (一) 国有企业竞争力与走向
- (二) 外资企业
- (三) 民营企业扩张与份额
- (四) 内外资重点企业综合
- (五) 主要品牌与海外扩张

三、2007-2008年中国抛光液重点省市竞争力评价与分析

- (一) 在全国的地位
- (二) 政策导向与主要竞争力指标分析

第八章 2007-2008年中国抛光液重点企业竞争力与关键性数据分析

一、天津西立卡晶体抛光材料有限公司

- (一) 企业概况
- (二) 企业财务分析

二、天津晶岭电子材料科技有限公司

- (一) 企业概况
- (二) 企业财务分析

三、上海新华化工厂

- (一) 企业概况
- (二) 企业财务分析

四、安集微电子有限公司

- (一) 企业概况
- (二) 企业财务分析

五、北京国瑞升科技有限公司

- (一) 企业概况

(二) 企业财务分析

六、东莞皓志稀土材料有限公司

(一) 企业概况

(二) 企业财务分析

七、江苏吉瑞卡微电子纳米材料有限公司

(一) 企业概况

(二) 企业财务分析

第九章 2008-2010年中国抛光液行业发展及投资分析

一、2008-2010年中国抛光液行业发展趋势分析

(一) 2008-2010年中国抛光液行业发展分析

(二) 2008-2010年中国抛光液行业技术开发方向

(三) 中国抛光液行业“十一五”整体规划及预测

二、2008-2010年中国抛光液行业投资环境分析

三、2008-2010年抛光液行业投资机会分析

四、2008-2010年中国抛光液行业投资风险分析

(一) 市场竞争风险

(二) 原材料压力风险分析

(三) 技术风险分析

(四) 政策和体制风险

(五) 外资进入现状及对未来市场的威胁

第十章 2008-2010年中国抛光液企业投资战略与专家建议分析

一、2008-2010年中国抛光液企业战略分析

(一) 核心竞争力

(二) 市场机会分析

(三) 市场威胁分析

(四) 竞争地位分析

二、投资建议

附件1 抛光剂我国专利目录

附件2 半导体用抛光剂的相关文献

图表目录：(部分)

图表：CMP的耗材及其成长趋势

图表：2007-2008年耗材占总成本的比率

图表：硅片抛光过程的示意图及实物图

图表：化学机械抛光设备实物图

图表：CMP成抛光精密（ $<0.25\mu\text{m}$ ）IC的唯一技术

图表：晶圆上CMP的次数乃随线宽的减少而快速增加，IC的层数及种类将越来越多

图表：CMP的使用次数逐年增加

图表：砷化镓单芯片切磨抛工艺流程图

图表：全球半导体市场预测

图表：世界半导体产品的组成

图表：2000-2007年全球硅片出货量变化率

图表：2000-2007年全球硅片销售额增长率

图表：2006年全球不同硅片市场比例

图表：世界不同直径尺寸硅片市场发展趋势

图表：2001-2007年我国半导体硅材料企业总销售收入

图表：2001-2007年国内硅材料现状

图表：2007年中国硅抛光片（含外延）占世界市场份额

图表：晶体硅产业链

图表：半导体硅材料产业链

图表：硅抛光片生产工艺流程

图表：光伏发电产业的产业链分支

图表：硅片加工工艺流程

图表：硅单晶抛光片生产线

图表：抛光测试

图表：硅抛光片

图表：2003-2007年国内不同规格尺寸硅抛光片产量

图表：2007年国内主要硅抛光片产品结构

图表：2007年中国抛光片占世界产量百分比

图表：2007年国内主要半导体抛光液应用厂家抛光片产量调查

图表：2005-2010年国内半导体抛光液需求量调查及预测

图表：半导体用抛光液主要应用领域

图表：硅片质量参数随IC特征尺寸的变化（ITRS）

图表：2005-2010年全球半导体各应用领域市场销售额预测

图表：2000-2007年全球硅片出货量

图表：2002-2007年中国分立器件市场销售量规模与增长

图表：2006年中国分立器件市场细分产品销售量结构

图表：硅抛光片产品参数

图表：2006-2007年国内主要生产厂家抛光片的年产量及抛光液的使用情况

图表：2007-2008年国内主要分立器件芯片生产企业

图表：国外生产抛光液的主要公司及产品牌号

图表：美国的Rodel & Onden Nalco公司主要产品规格

图表：DUPON公司四种产品规格

图表：GLANZOX系列产品规格

图表：COMPOL系列产品规格

图表：天津西立卡抛光液系列产品参数

图表：北京国瑞升碱性CMP抛光液参数

图表：东莞皓志KA-901硅溶胶简介

图表：2008-2010年国内集成电路用抛光片市场需求预测

图表：2008-2010年国内分立器件用硅片市场需求情况与预测

图表：2008-2010年国内分立器件用抛光液需求量调查及预测

图表：2008-2010年中国分立器件市场规模预测

图表：2008-2010年中国抛光液行业市场前景预测

图表：2008-2010年中国抛光液行业市场价格走势预测

图表：2008-2010年中国抛光液行业发展前景预测

图表：略……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200810/5810.html>